

2015年3月期 第1四半期(2014年4月～6月)

東京エレクトロン 決算説明会

内容:

➤ 第1四半期連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

➤ 2015年3月期 市場環境および上期業績予想修正

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2014年7月29日

第1四半期連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

2014年7月29日

損益状況

(億円)

	2014年3月期				2015年3月期	対前年 1Q増減
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
売上高	1,034	1,510	1,384	2,192	1,513	+46%
売上総利益 下段: 売上総利益率	299 28.9%	501 33.2%	503 36.4%	715 32.6%	553 36.6%	+85%
販管費	395	423	412	465	383	-3%
営業利益 下段: 営業利益率	-96 -9.3%	78 5.2%	90 6.6%	249 11.4%	170 11.3%	—
税前利益	-98	95	-372	257	150	—
当期純利益	-29	54	-380	162	118	—
研究開発費	179	204	189	212	167	-7%
設備投資額	47	19	14	45	37	-22%
減価償却実施額	63	64	58	62	47	-25%

東京エレクトロン デバイスが持分法適用関連会社となり、
当期からEC/CN事業が連結対象外へ

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています

2

部門別売上高

(億円)

	2014年3月期								2015年3月期	
	1Q		2Q		3Q		4Q		1Q	
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
SPE	749	72%	1,198	79%	1,022	74%	1,817	83%	1,361	90%
FPD	49	5%	44	3%	88	6%	101	4%	139	9%
PVE	20	2%	12	1%	11	1%	-6	---	11	1%
EC/CN	214	21%	253	17%	260	19%	279	13%		
その他	1	0%	1	0%	0	0%	1	0%	1	0%
合計	1,034	100%	1,510	100%	1,384	100%	2,192	100%	1,513	100%

SPE
(半導体製造装置)

メモリ向け売上の回復が顕著。特にDRAM向けが好調。

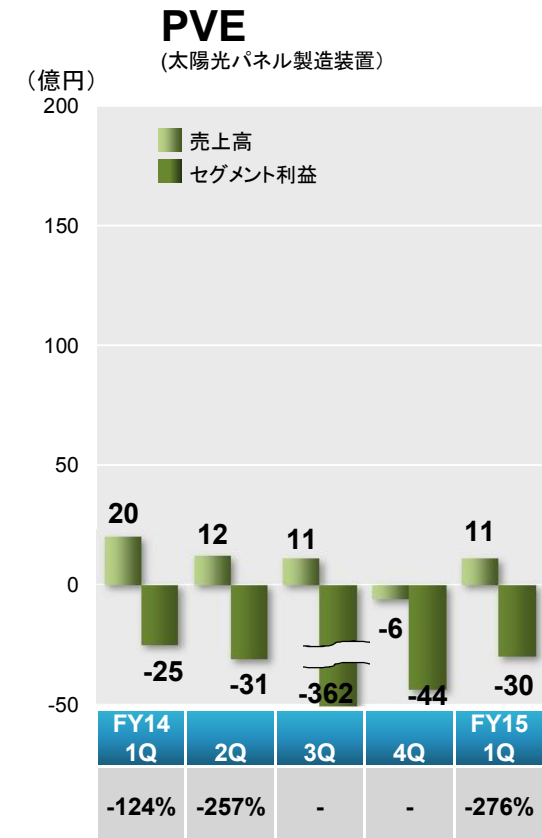
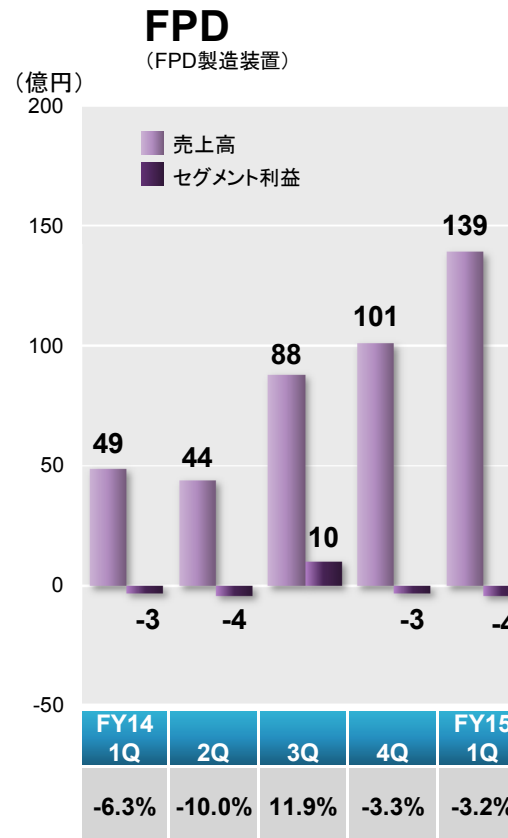
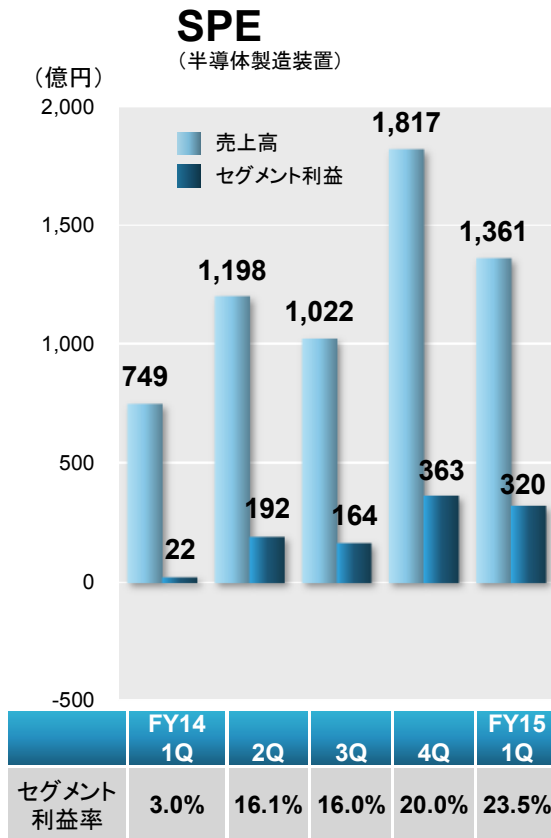
FPD
(FPD製造装置)

引き続き中国向けの売上が堅調。

PVE
(太陽光パネル製造装置)

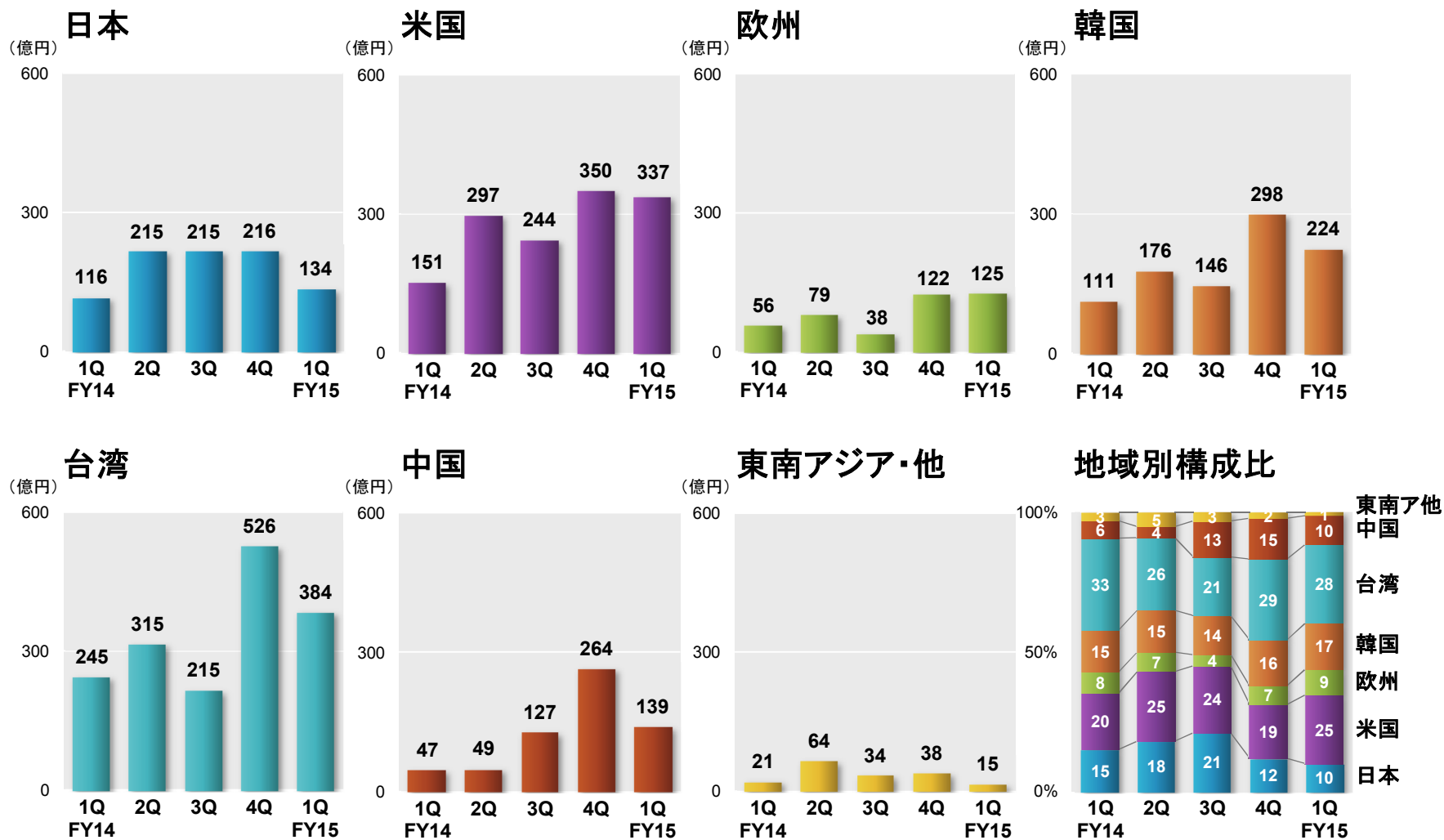
2014年3月末で製造開発および販売活動を終了。納入装置のサポートのみ継続。

セグメント情報



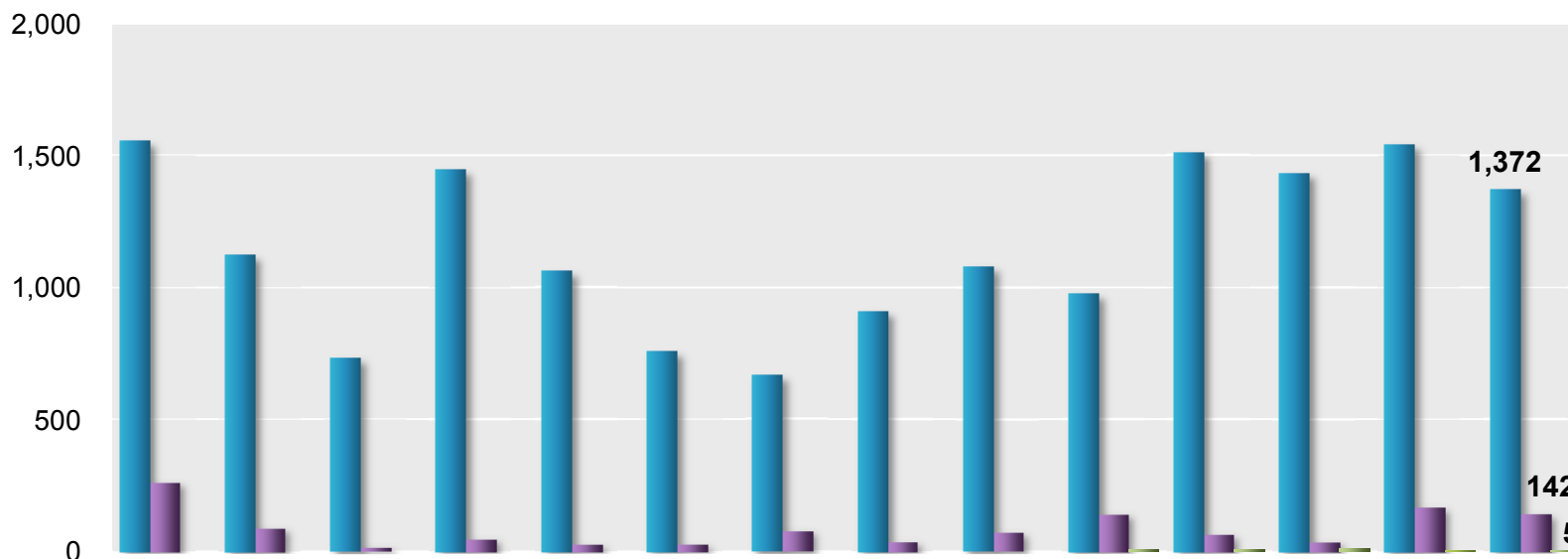
1. 従来のFPD/PVEセグメントを、FY14/1QよりFPDとPVEに分けて開示しています。
2. セグメント利益は、税前利益です。
3. 上記報告セグメントに配分していない全社費用があります。
4. PVEセグメントについては、FY14/4Qに工事進行基準売上高の進捗度を再精査しました。

SPE部門地域別売上高



受注額・受注残高

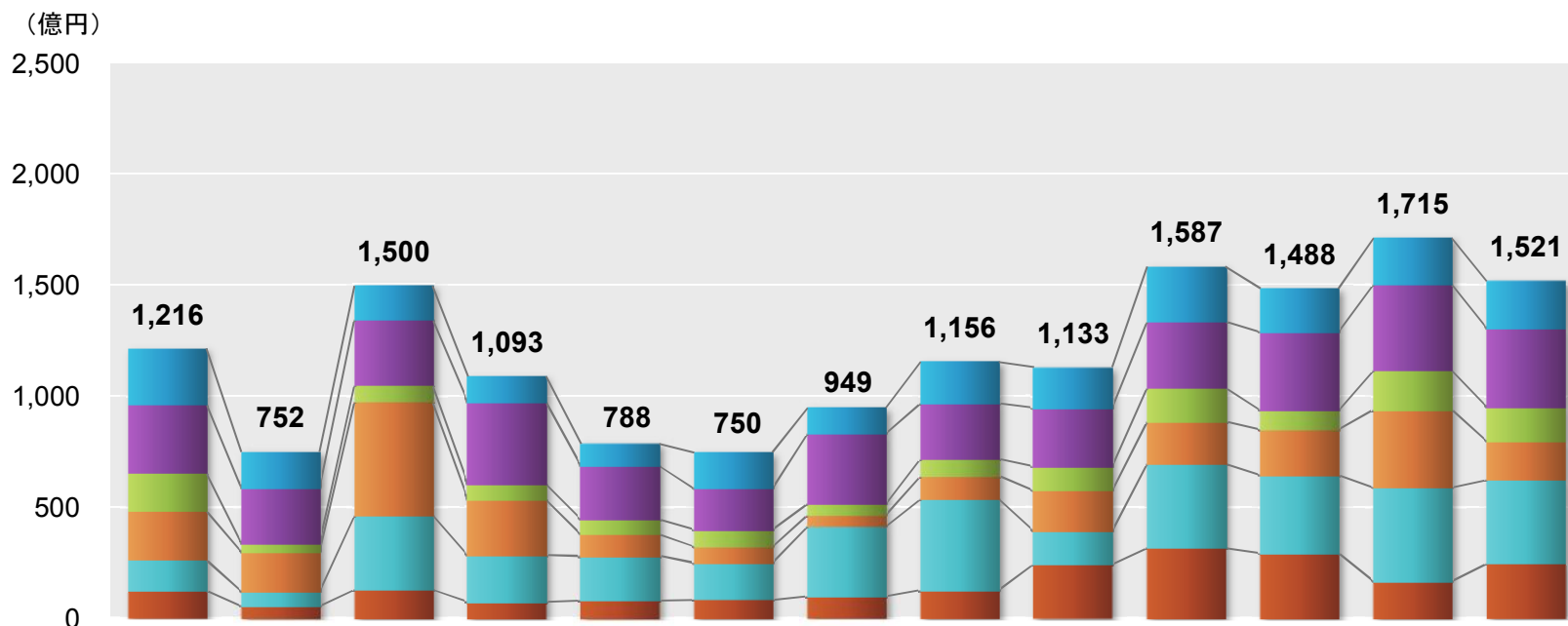
(億円)



	FY12 1Q	2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q	FY14 1Q	2Q	3Q	4Q	FY15 1Q
SPE受注額	1,126	735	1,449	1,064	760	669	913	1,082	977	1,513	1,434	1,544	1,372
FPD受注額	89	17	50	28	27	80	36	73	144	63	38	166	142
PVE受注額					0	0	0	0	11	11	14	5	5
SPE受注残高	2,207	1,667	2,201	1,886	1,577	1,187	1,426	1,416	1,645	1,960	2,372	2,099	2,110
FPD受注残高	618	394	278	142	122	158	148	160	255	274	225	290	293
PVE受注残高					0	-	84	84	76	74	77	89	84

FY12/4Q以前のPVEの受注額および受注残高はFPDとの合計額で表示しています。

地域別受注額：SPE+FPD+PVE

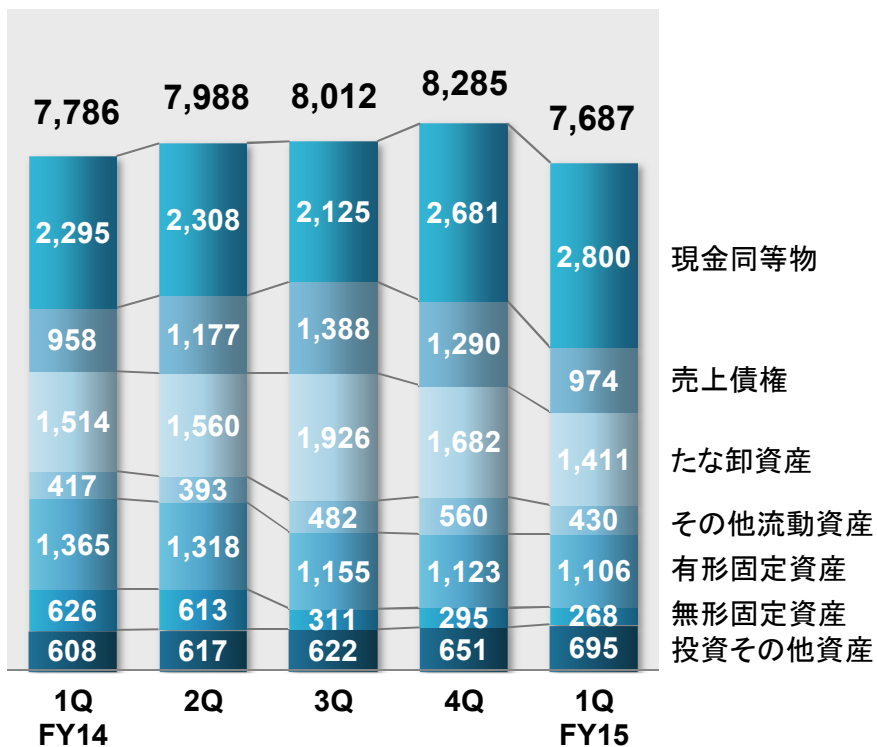


	FY12 1Q	2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q	FY14 1Q	2Q	3Q	4Q	FY15 1Q
国内	250	163	149	117	100	163	115	187	183	247	196	209	212
米国	311	248	297	368	240	184	317	249	264	298	353	389	352
欧州	172	39	76	70	68	77	50	77	109	153	85	175	155
韓国	219	179	511	251	97	73	52	105	182	191	206	350	176
台湾	137	66	335	210	200	167	313	410	149	378	352	423	377
中国・東南ア他	125	54	129	74	81	83	100	127	244	317	293	167	246

貸借対照表

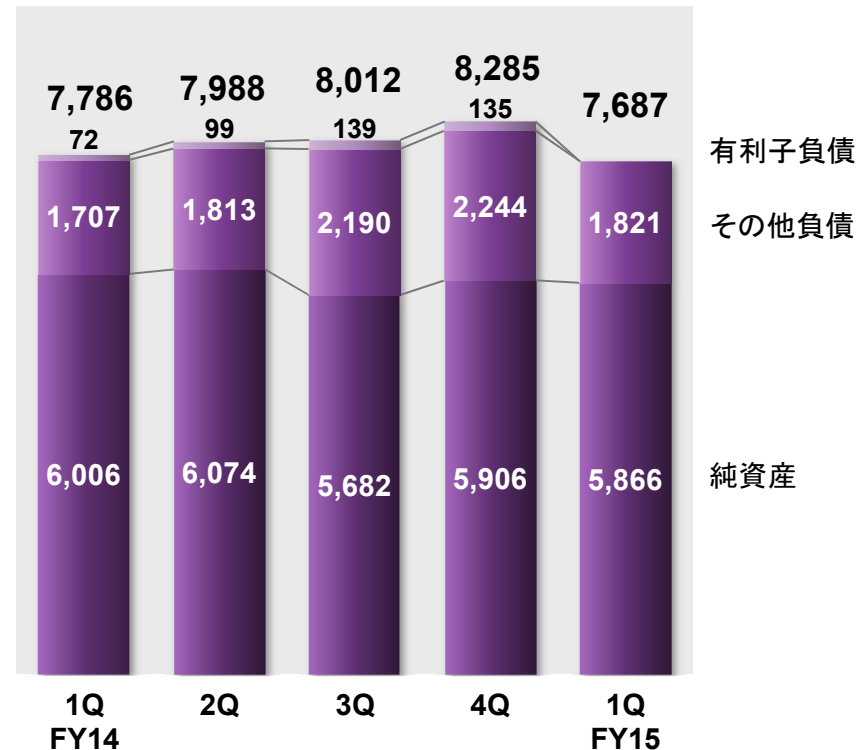
資産

(億円)



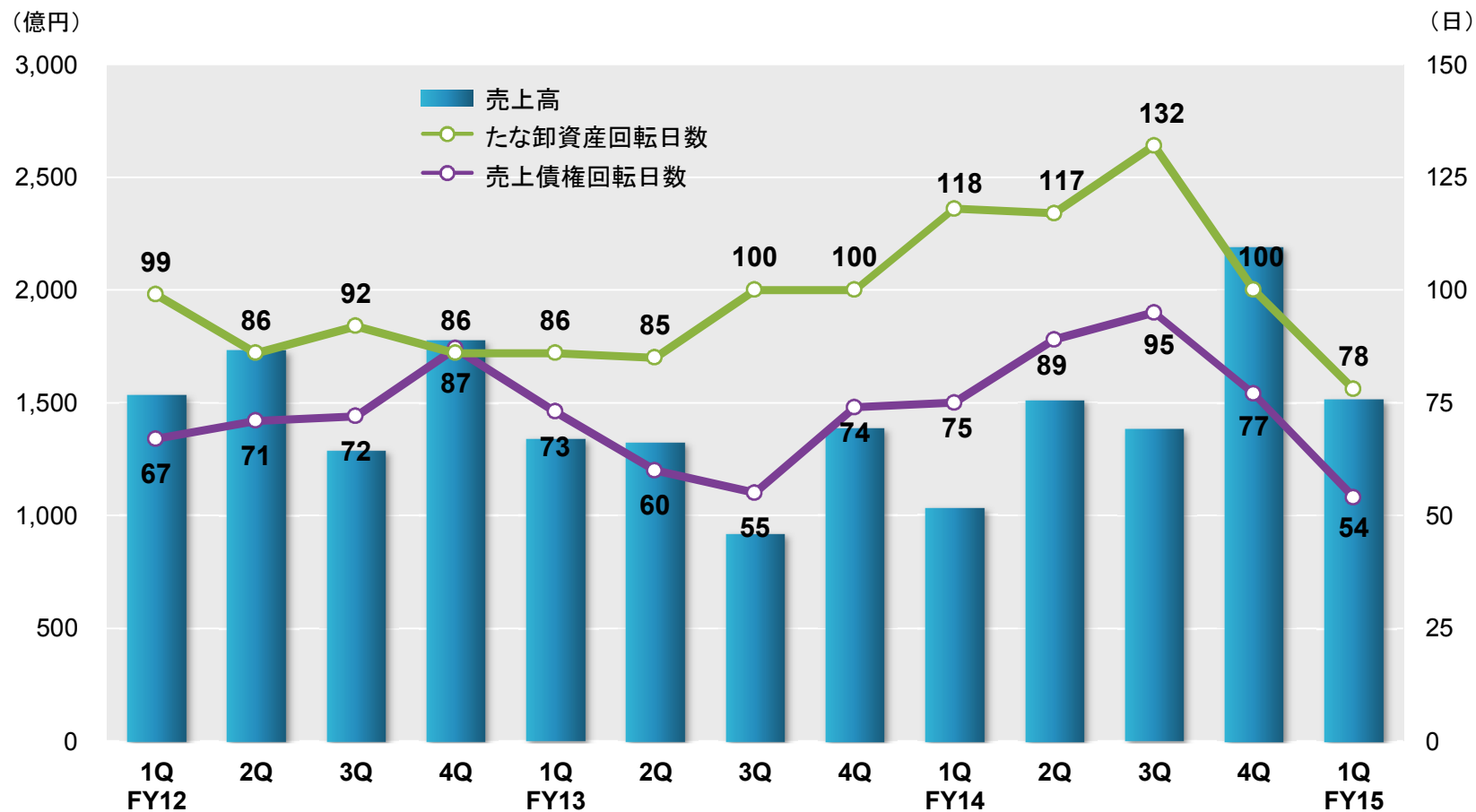
負債・純資産

(億円)



現金同等物: 現預金 + 短期投資等 (貸借対照表上の表示は「有価証券」)

たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

	2014年3月期 1Q	2015年3月期 1Q	(億円)
営業キャッシュ・フロー	△13	164	
税引前利益	△98	150	
減価償却費	63	47	
売上債権の減少(△増加)	51	82	
たな卸資産の減少(△増加)	△157	49	
仕入債務の増加(△減少)	7	△40	
法人税等の支払額または還付額	△17	△125	
その他	138	1	
投資キャッシュ・フロー	132	210	
設備投資	△32	△30	
満期3ヵ月超の預金等の増減額	176	223	
その他	△12	18	
財務キャッシュ・フロー	△14	△46	
配当金支払い	△46	△44	
その他	32	△1	
現金及び現金同等物の期末残高	923	1,389	
満期3ヵ月超の定期預金・短期投資の期末残高	1,371	1,410	
現金及び現金同等物＋満期3ヵ月超の定期預金・短期投資等の期末残高	2,295	2,800	



2015年3月期 市場環境および 上期業績予想修正

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2014年7月29日

2015年3月期 市場環境と事業戦略



TOKYO ELECTRON

CORP IR/July 29, 2014



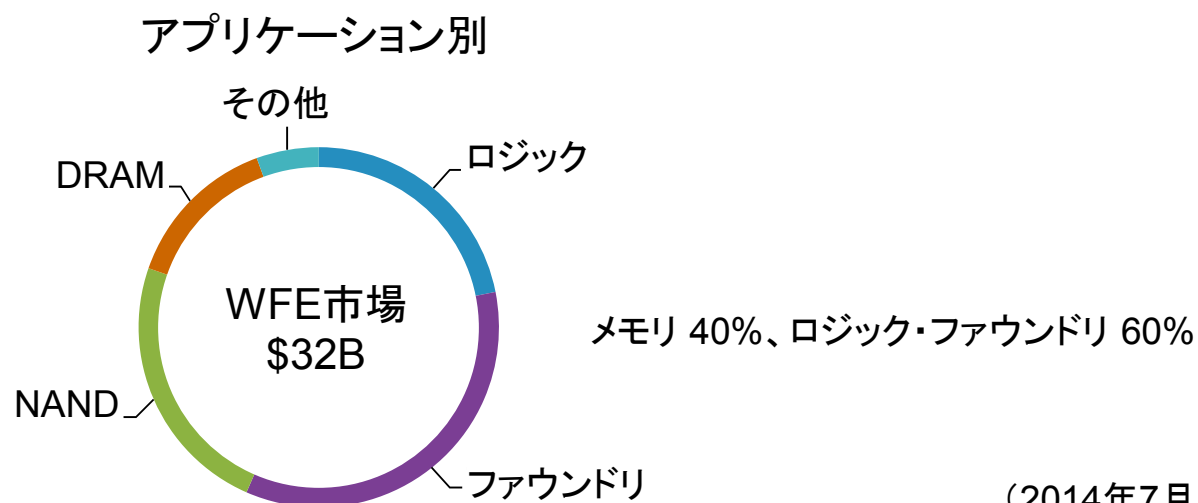
SPE市場環境

▶ 半導体設備投資

CY2014の半導体前工程(WFE)の設備投資額は、前年比+15%前後の\$32B程度を見込む。

モバイル機器市場は台数ベースで対前年比+20%と予測されており、特にメモリ向け設備投資が拡大すると予測。

- DRAM/NAND: モバイル機器が引き続き需要を牽引し設備投資は拡大
- ファウンドリ: モバイル機器向け半導体設備投資は対前年比増加
- ロジック: PC市場は堅調に推移し、WFE設備投資は前年並み

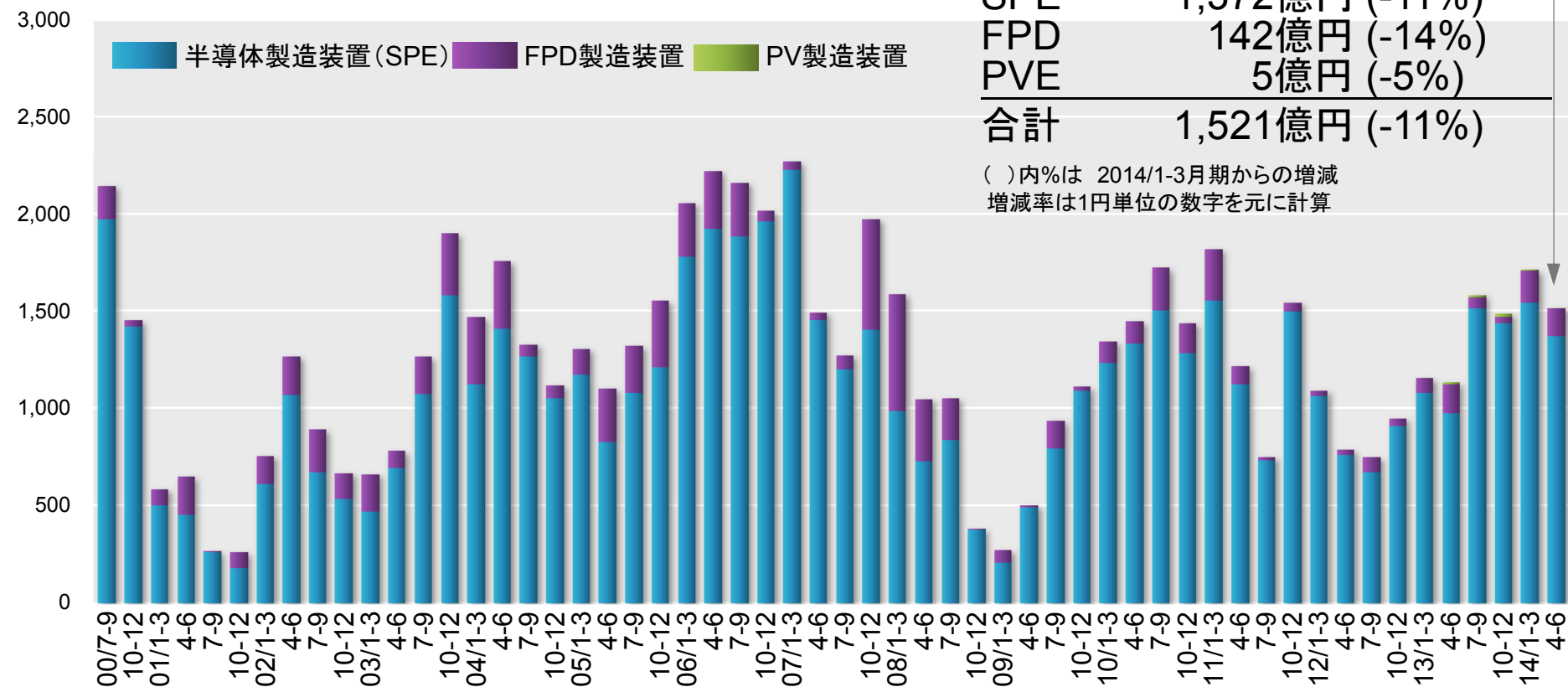


(2014年7月時点での見方)

14

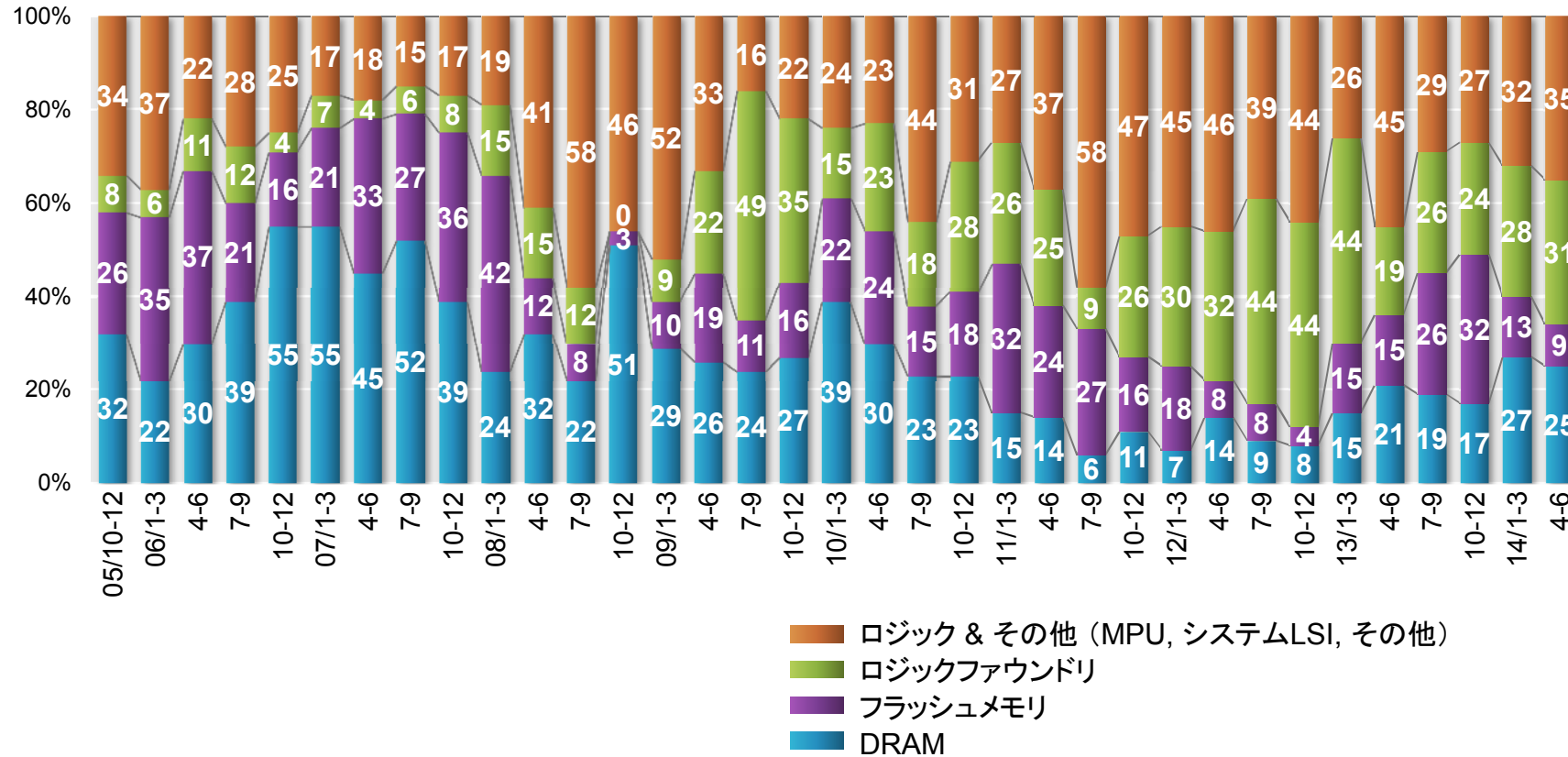
四半期 受注額

(億円)



2012/1-3月期以前のPV製造装置の受注額は
FPD製造装置の値に含まれています。

アプリケーション別SPE受注額



- ロジック & その他 (MPU, システムLSI, その他)
- ロジックファウンドリ
- フラッシュメモリ
- DRAM

グラフは装置本体受注における構成比を示しています。

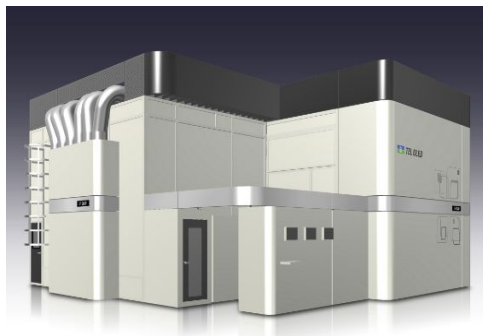
FPD市場環境と事業戦略

▶ FPD設備投資

- CY2014の液晶パネル用製造装置の需要は、中国での大型パネル向け設備投資を中心に堅調。また、CY2015は、中小型パネル向け投資の増加が予想され、引き続き堅調な投資が見込まれる。有機ELテレビ市場の立ち上がりは2016年以降。

▶ 事業戦略

- 最新モデルICPエッチング装置を顧客展開。酸化物半導体、OLED等の新しい技術ニーズに対応した差別化製品により、収益拡大を目指す。
- インクジェット方式の有機EL成膜装置の販売開始。



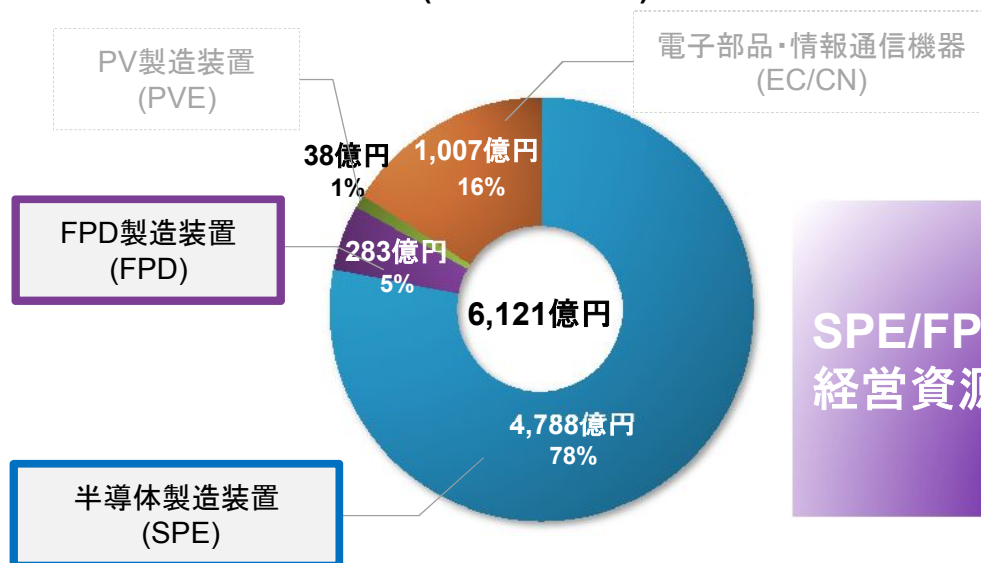
有機ELパネル製造用インクジェット描画装置
Elius™ 2500

- 材料使用効率に優れる
- 大気圧下でのプロセスが可能

コアビジネスへの集中と利益率改善

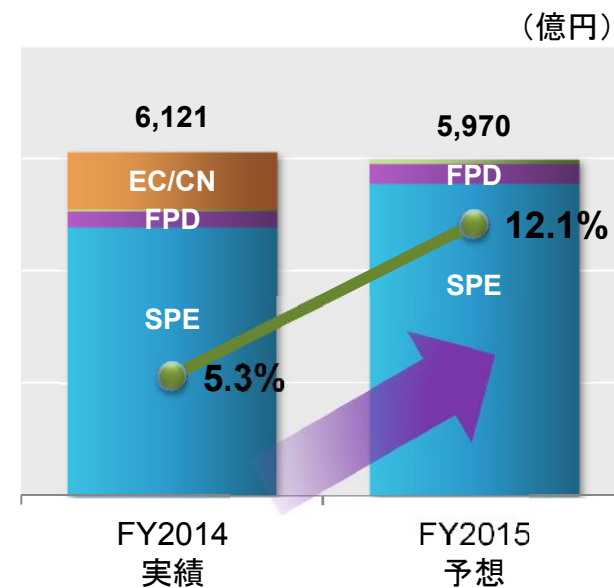
- ▶ 経営資源をSPE/FPDに集中
- ▶ 開発拠点の最適化
- ▶ 営業利益率を改善 (FY2014: 5.3% ⇒ FY2015: 12.1%)

FY2014 連結売上高
(2013.4-2014.3)



SPE/FPDに
経営資源集中

連結売上高と営業利益率
(FY2014 vs. FY2015)



2015年3月期 上期業績予想修正



TOKYO ELECTRON

CORP IR/July 29, 2014



2015年3月上旬業績予想修正

▶ 堅調なメモリ向け投資により、上期業績予想を上方修正

(億円)

	FY2014	FY2015				
		上期(予想)		下期	通期	通期 対前年 増減
		新予想	修正額*	(参考情報)	(参考情報)	
売上高	6,121	2,900	+120	3,070	5,970	-2%
SPE	4,788	2,700	+100	2,850	5,550	+16%
FPD	283	180	+20	160	340	+20%
PVE	38	20	-	60	80	-
EC/CN**	1,007					
その他	4	0	-	-	-	-
営業利益	322	245	+65	480	725	+403
下段: 営業利益率	5.3%	8.4%	+1.9pts	15.6%	12.1%	+6.8pts
税前利益	-117	220	+65	-	-	-
当期純利益	-194	155	+45	-	-	-

アプライド マテリアルズとの経営統合を2014年の後半に予定しているため、上期までの業績予想を開示しています。下期および通期は参考情報です。

*修正額: 2014/4/28に発表した業績予想からの修正額を示しています。

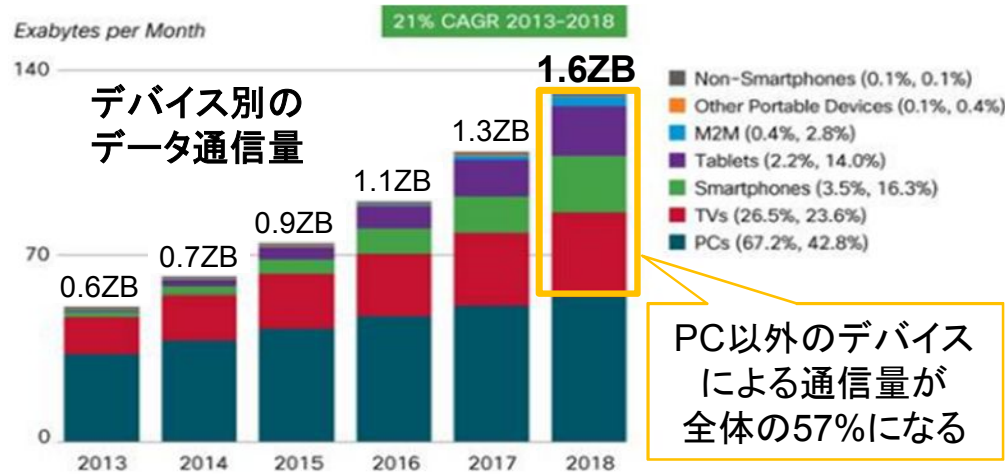
**EC/CN事業を行っている東京エレクトロデバイス、は、FY2015より当社の連結子会社から持分法適用会社となりました。

SPE: 半導体製造装置 FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置 PVE: 太陽光パネル製造装置 EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク

20

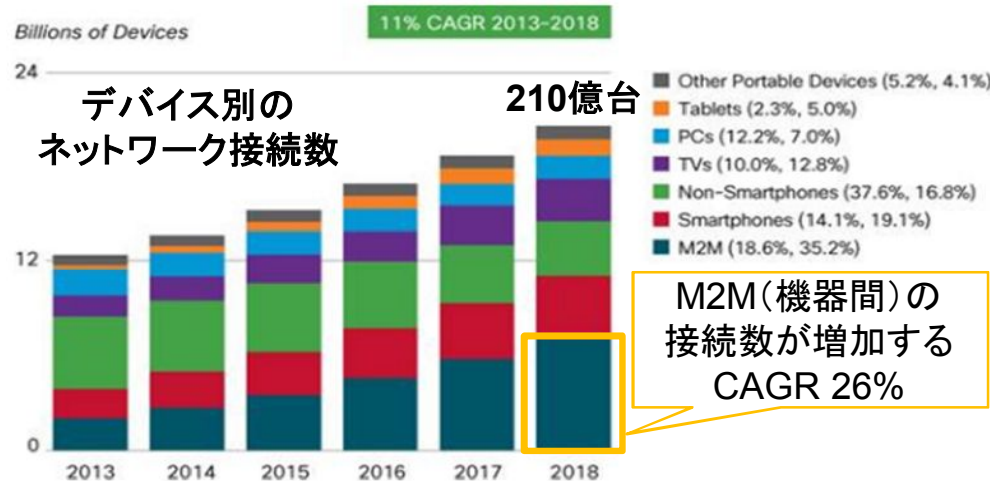
中長期の市場環境と事業戦略

急増するネットワークデータ通信量 (IPトラフィック)



▶ 年間データ通信量は、2016年にゼタバイトの大台を超え、2018年には1.6ゼタバイトに達する見込み。(CAGR 21%)

▶ 2013年には、PC以外のデバイスによるデータ通信量は全体のわずか33%だが、2018年には57%に増加する見込み。ゼタバイト(ZB):データ量の大きさを表す単位



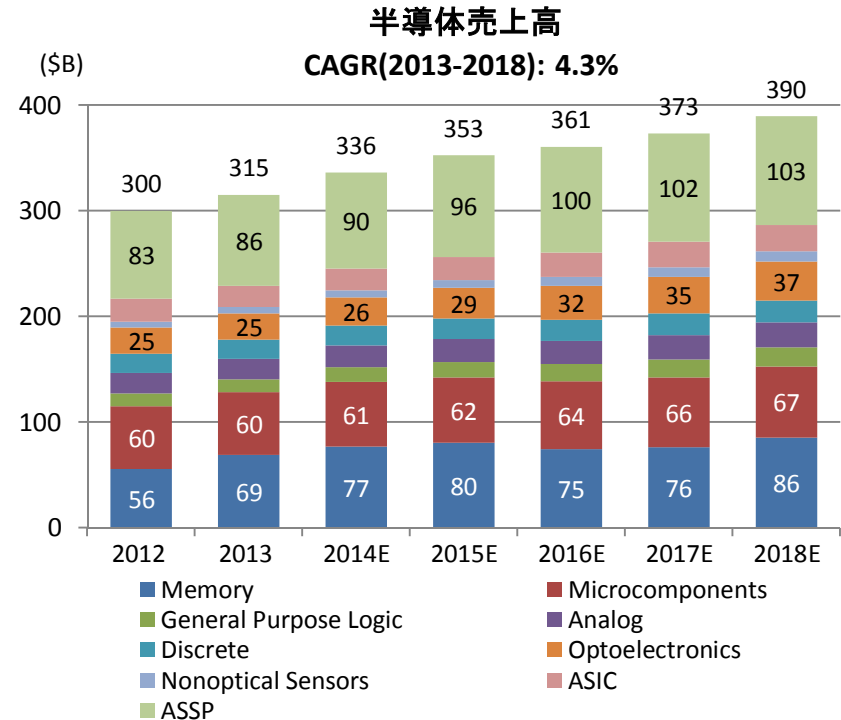
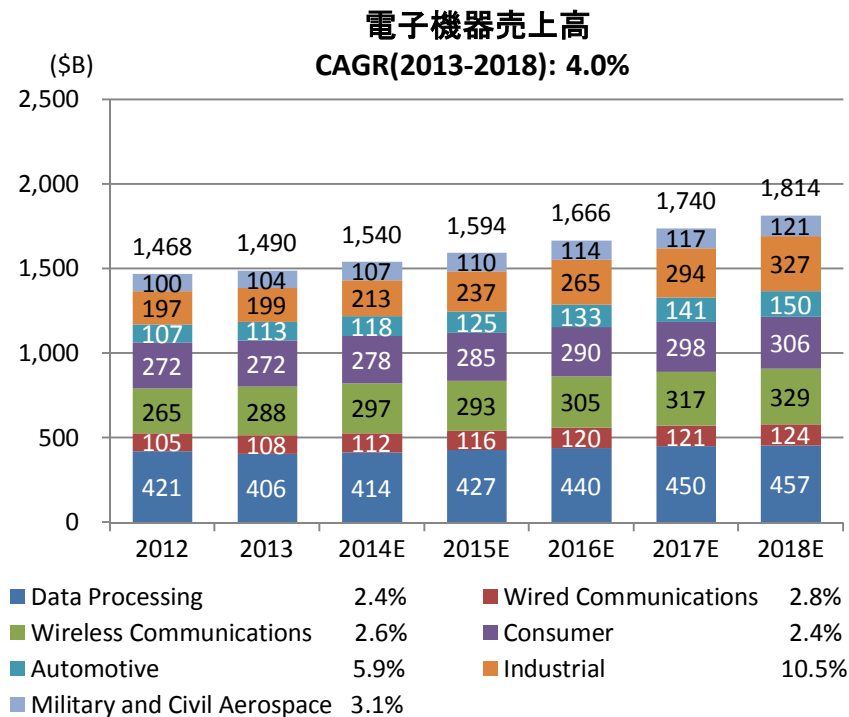
▶ 2018年にはネットワークに接続されるデバイス数が210億台に達する見込み。(CAGR 11%)

▶ スマートメータ、医療、運輸をはじめ Internet of Everythingの成長が期待され、2018年には機器間の接続が73億台に達する見込み。

(出所: Cisco Visual Networking Index 2014)

電子機器および半導体売上高の見通し

- ▶ 電子機器売上高は、CAGR4.0%で成長する
- ▶ 半導体売上高は、CAGR4.3%で成長する
PC、サーバ、モバイル、SSD向けの需要が 50-55%を占める

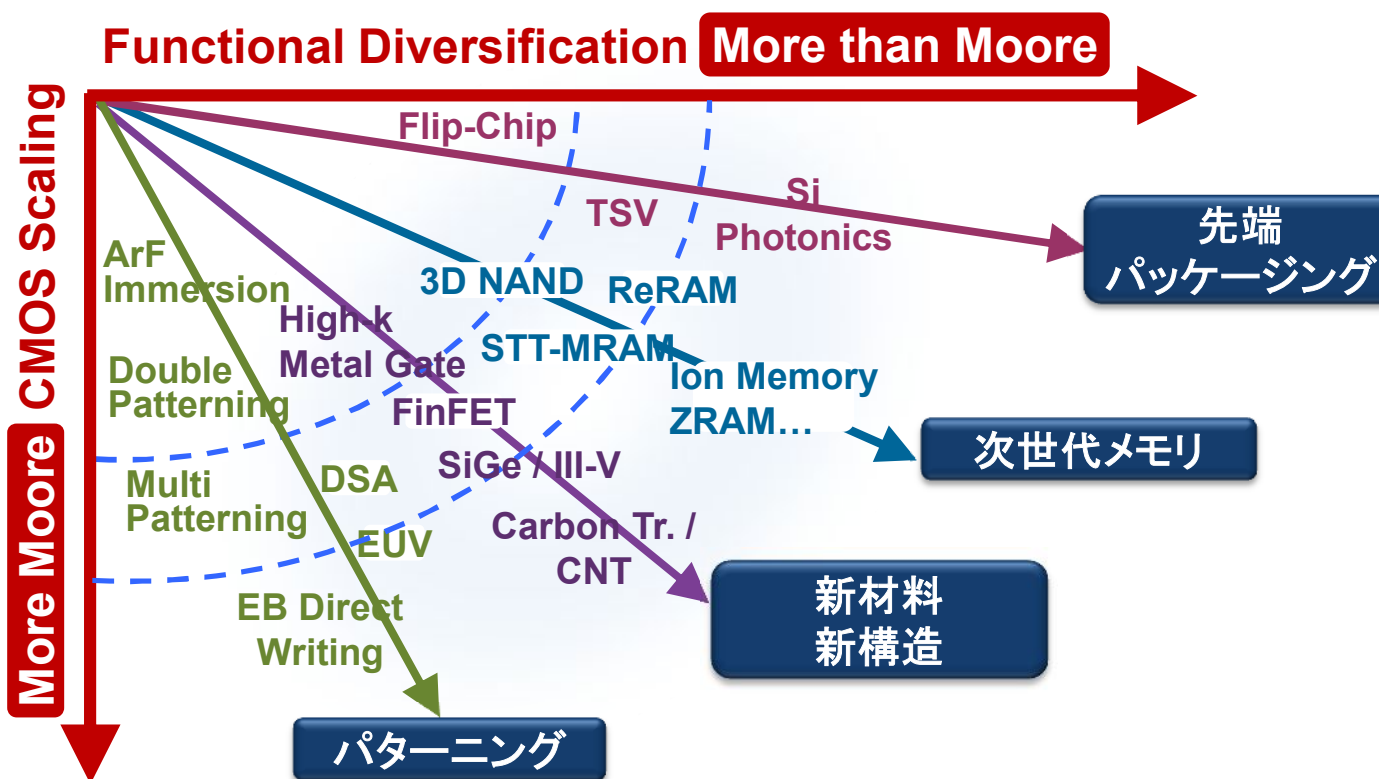


出所: Gartner, "Semiconductor Forecast Database, Worldwide, 2Q14 Update" 25 June 2014 E=予想

The Gartner Report described herein, (the "Gartner Report") represents data, research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Each Gartner Report speaks as of its original publication date (and not as of the date of this enterprise report) and the opinions expressed in the Gartner Report are subject to change without notice.

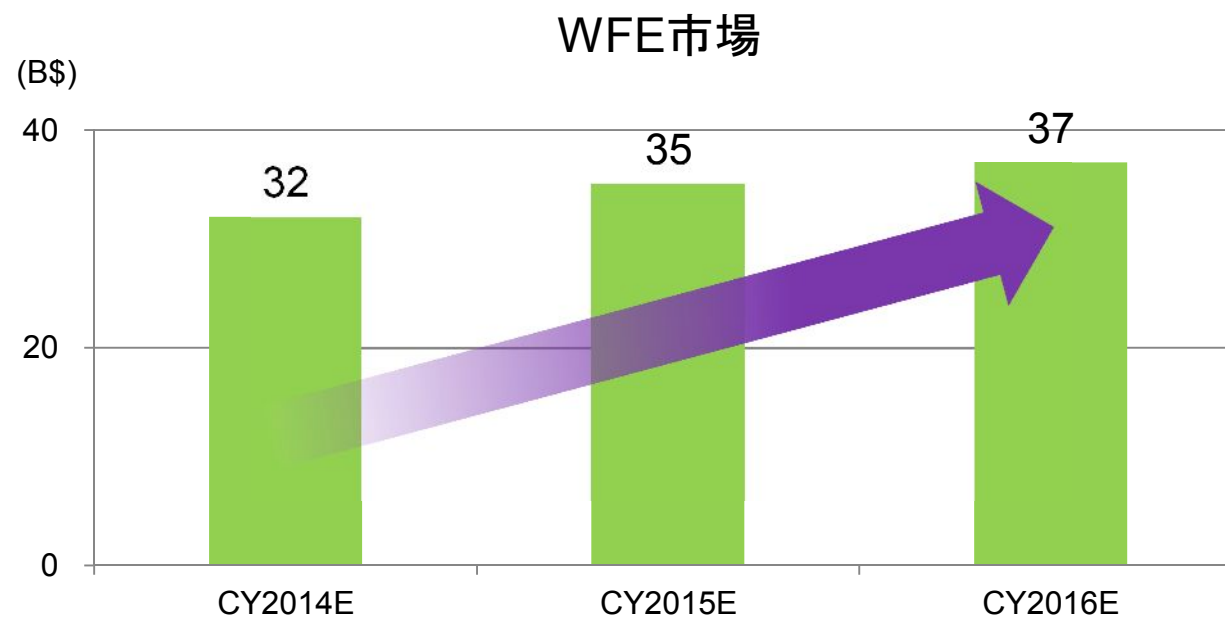
多様化する技術要求 (Inflection point)

- ▶ 低消費電力化、高速化、大容量化等のデバイスの性能向上とコスト低減を可能とする新しい技術要求が、今後のWFEの成長を牽引する



CY2016 WFEの見通し (2014年7月時点での見方)

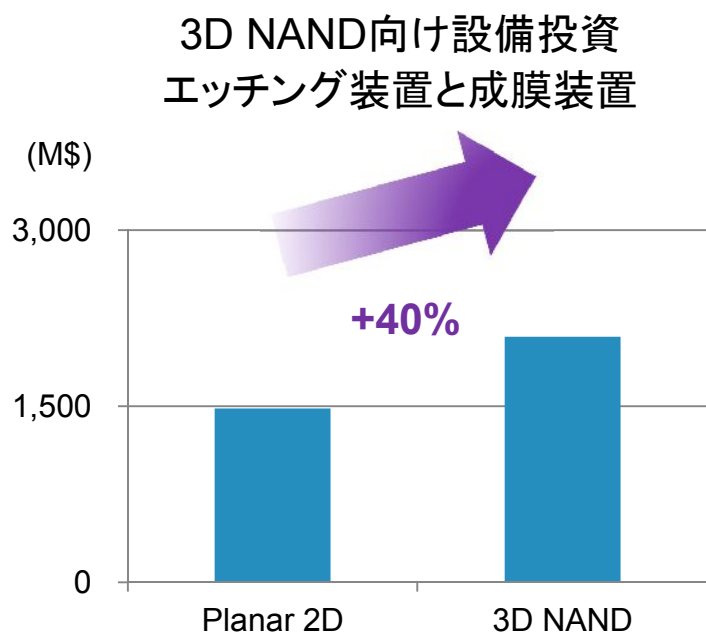
- ▶ モバイルとネットワークの拡大が、今後も継続して半導体市場とWFEを牽引する
- ▶ 多様化する技術要求が成長機会を生み出す



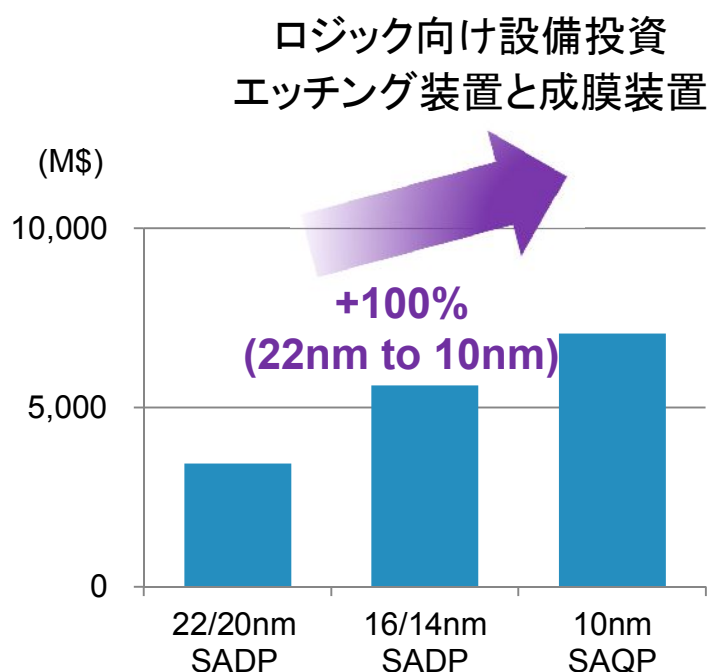
(出所: 当社推定)

技術の変革点が成長機会を生み出す

- ▶ 3D NAND、FinFET等の3次元構造へのシフトやマルチパターンニングにより、エッチング装置と成膜装置市場が拡大



(出所: TEL estimate based on IC knowledge)
Tool investment cost for 100k wafers per month fab

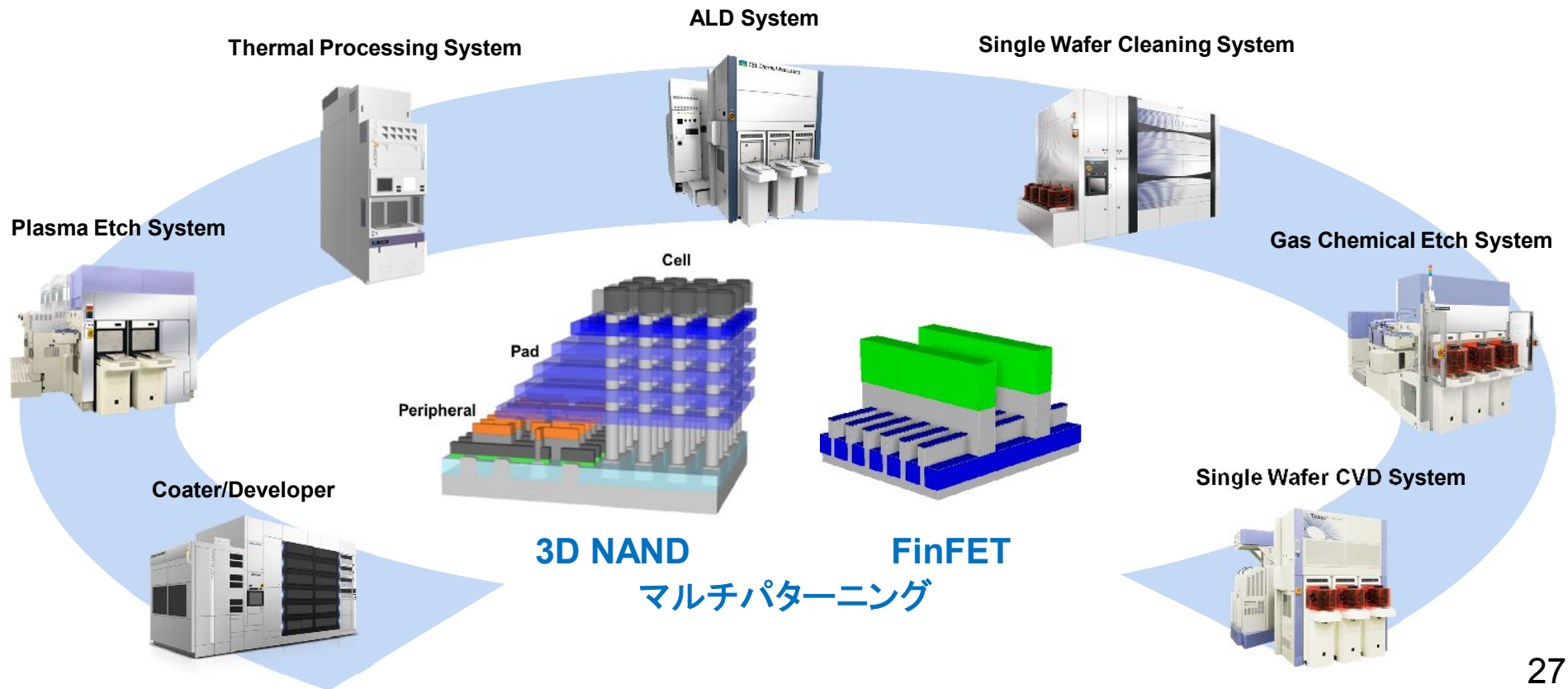


(出所: TEL estimate based on IC knowledge)
Tool investment cost for 100k wafers per month fab

SADP: Self-aligned double patterning, SAQP: Self-aligned quadrupling patterning

新しい技術に対応する製品戦略

- ▶ 3D NAND、FinFET、マルチパターニング等の新技術に対応する革新的な差別化製品でポジション向上を目指す
- ▶ CY2014 WFEシェアは13-14%を見込む



新社名「Eteris(エタリス)」を発表

- ▶ エタリスは、Eternal Innovation for Societyをコンセプトとして、新会社の原動力となる精神を具体化し、人々の暮らしをより豊かにする技術革新を創出し、実現するという未来へのコミットメントを表しています。



まとめ

1. CY2014 WFEは、前年比15%の増加を見込む。モバイル機器に牽引され、メモリ、ファウンドリ顧客の投資は引き続き旺盛
2. SPE/FPD事業に経営資源を集中し、利益改善に取り組む
3. 堅調なメモリ向け投資により、上期業績予想を上方修正
4. CY2014 WFEシェアは13-14%を見込む
5. アプライド マテリアルズとの経営統合完了は、予定通り2014年の後半を見込む

▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV：フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

50 Years